



## 一部の Virtex-II Pro FPGA および Virtex-4 FPGA デバイスに使用される フリップチップ基板材の BT から ABF への変更

XCN09013 (v1.0) 2009 年 10 月 5 日

製品変更通知

### 概要

この通知は、一部の Virtex<sup>®</sup>-II Pro FPGA および Virtex<sup>®</sup>-4 FPGA のデバイス/パッケージで使用されるビルトアップ層の材料が BT から ABF に変更されることをお知らせするものです。この変更による、フォーム、形状、機能、あるいは信頼性に対する影響はありません。

### 変更内容

次の表に記載する該当製品のビルトアップ層の材料が BT から ABF に変更されます。この変更は、サブストレート メーカーによる UV レイザー装置の使用が段階的に廃止になることを受けたものです。ABF 材ではビアの形成に UV レイザーが不要なため、フリップチップ製品の確実な供給を目的として実施されます。その他の Virtex-II Pro FPGA、Virtex-4 FPGA、および Virtex<sup>®</sup>-5 FPGA 製品に対する ABF 材は既に評価済みで製造段階に入っています。

### 該当製品

この変更は、コマーシャル (C) およびインダストリアル (I) グレード デバイスの全スピードグレード、パッケージ、温度範囲の製品に該当します。オートモーティブ デバイスには該当しません。次の表に、該当製品番号を示します。

表 1: 該当製品

ザイリンクス製品	パッケージ	変更内容
XC4VLX15	FF(G)668	Build-up materials set change from BT to ABF
XC4VLX40	FF(G)668	Build-up materials set change from BT to ABF
XC4VSX25	FF(G)668	Build-up materials set change from BT to ABF
XC4VLX15	SF(G)363	Build-up materials set change from BT to ABF
XC4VLX200	FF(G)1513	Build-up materials set change from BT to ABF
XC4VFX140	FF(G)1517	Build-up materials set change from BT to ABF
XC2VP70	FF(G)1517	Build-up materials set change from BT to ABF

メモ : XC2VP70-FF(G)1704 および XC2VP100-FF(G)1704 は現在調査中であり、今後の PCN に含まれることが考えられます。

### キーデートおよび注文情報

PCN 発行の 90 日後から、ビルトアップ層に BT および ABF を使用した製品が混在出荷されます。

## 品質評価データ

Virtex-II Pro FPGA および Virtex-4 FPGA デバイスの品質評価データとデバイス信頼性レポートは、[UG116](#) から入手可能です。また、この PCN に関連する広範な品質評価データは、下記その他の資料に記載されている [RPT141](#) から入手できます。

## お問い合わせ先

この通知に対する回答は必要ありません。技術的な質問につきましては、[ザイリンクス テクニカル サポート](#)までお問い合わせ下さい。

**重要なお知らせ** : カスタマ変更通知 (PCN、PDN、Quality Alert) は、弊社のサポートウェブ サイト <http://japan.xilinx.com/support> から e-mail によるアラート配信として受信できます。アラートにご登録後、My アラートにカスタマ変更通知が含まれるようにカスタマイズして下さい。これにより、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラーラ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができるようになります。登録方法は、[ザイリンクス アンサー# 18683](#) を参照して下さい。

## その他の資料

Qualification Report (RPT141)

<https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=140202>

デバイス信頼性レポート (UG116)

[http://www.xilinx.com/support/documentation/user\\_guides/ug116.pdf](http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug116.pdf)

---

## 改訂履歴

次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	内容
2009/10/05	1.0	初版リリース

## Disclaimer

THE XILINX HARDWARE FPGA AND CPLD DEVICES REFERRED TO HEREIN (“PRODUCTS”) ARE SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE XILINX LIMITED WARRANTY WHICH CAN BE VIEWED AT <http://www.xilinx.com/warranty.htm>. THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT EXTEND TO ANY USE OF PRODUCTS IN AN APPLICATION OR ENVIRONMENT THAT IS NOT WITHIN THE SPECIFICATIONS STATED ON THE XILINX DATA SHEET. ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. PRODUCTS ARE NOT DESIGNED OR INTENDED TO BE FAIL-SAFE, OR FOR USE IN ANY APPLICATION REQUIRING FAIL-SAFE PERFORMANCE, SUCH AS LIFESUPPORT OR SAFETY DEVICES OR SYSTEMS, OR ANY OTHER APPLICATION THAT INVOKES THE POTENTIAL RISKS OF DEATH, PERSONAL INJURY OR PROPERTY OR ENVIRONMENTAL DAMAGE (“CRITICAL APPLICATIONS”). USE OF PRODUCTS IN CRITICAL APPLICATIONS IS AT THE SOLE RISK OF CUSTOMER, SUBJECT TO APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS. ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

この通知は、英語版 (XCEN09013、バージョン 1.0、2009 年 10 月 5 日発行) を翻訳したものです。